



Electronics for the Future

決算発表 補足資料

2024年度 第4四半期業績

2025年5月14日
ローム株式会社
広報IR部

2024年度 第4四半期 実績 業績報告 (前年同期比)



(単位：億円)

	FY2024 第4四半期 実績	FY2023 第4四半期 実績	増減額	増減率
売上高	1,038	1,126	▲88	▲7.8%
営業利益	▲289	26	▲315	-
(対売上比率)	(▲27.9%)	(2.4%)	-	-
経常利益	▲300	90	▲390	-
(対売上比率)	(▲28.9%)	(8.1%)	-	-
純利益	▲502	88	▲590	-
(対売上比率)	(▲48.4%)	(7.9%)	-	-
EBITDA	▲70	238	▲308	-
(対売上比率)	(▲6.8%)	(21.2%)	-	-

期中平均レート(¥/US\$) (152.95円) (147.87円)

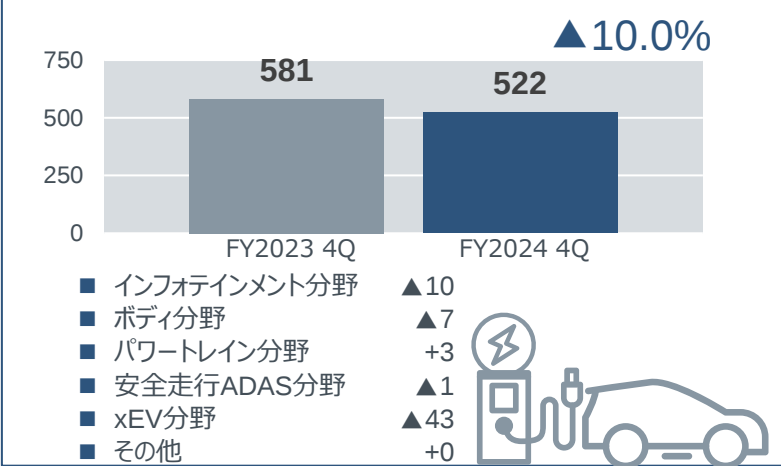
期末レート(¥/US\$) (149.52円) (151.41円)

(単位：億円)

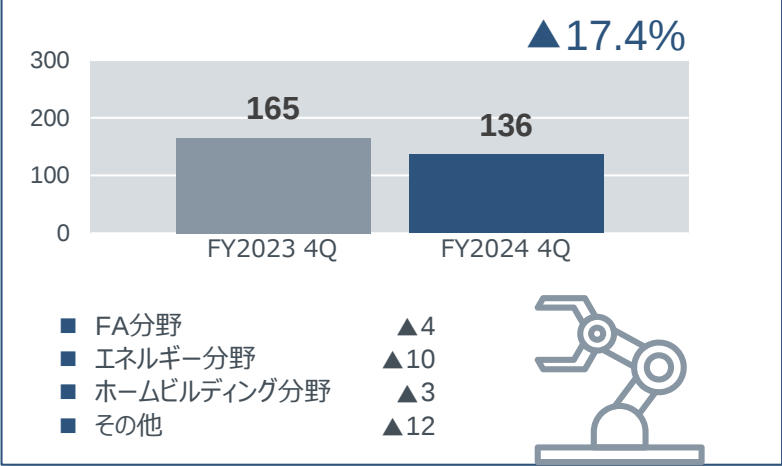
四半期売上高



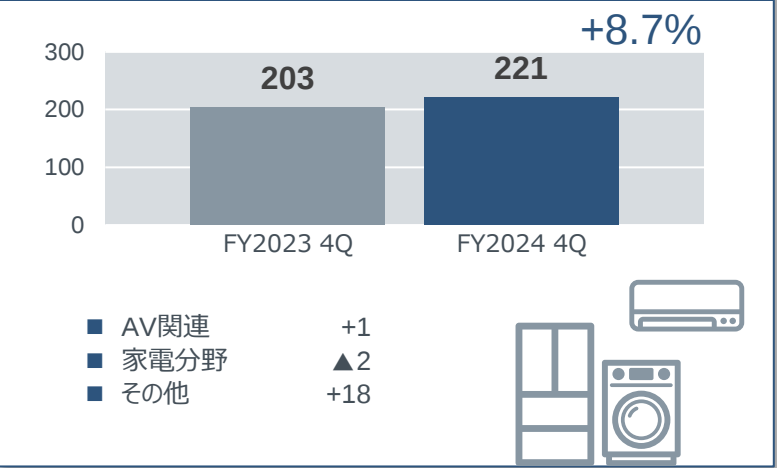
自動車



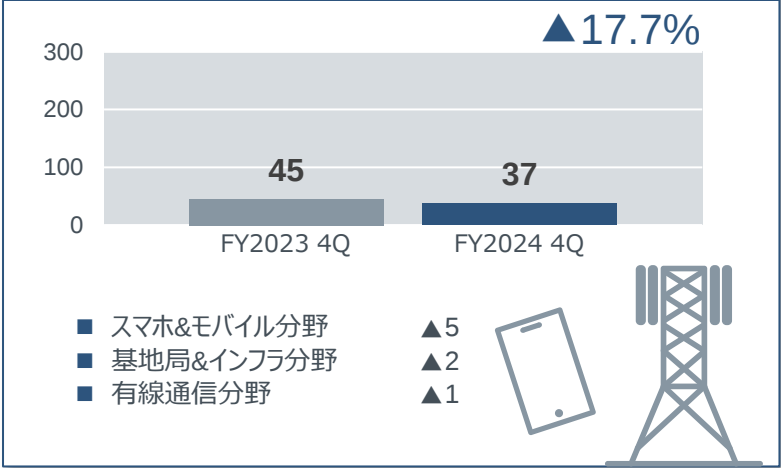
産機



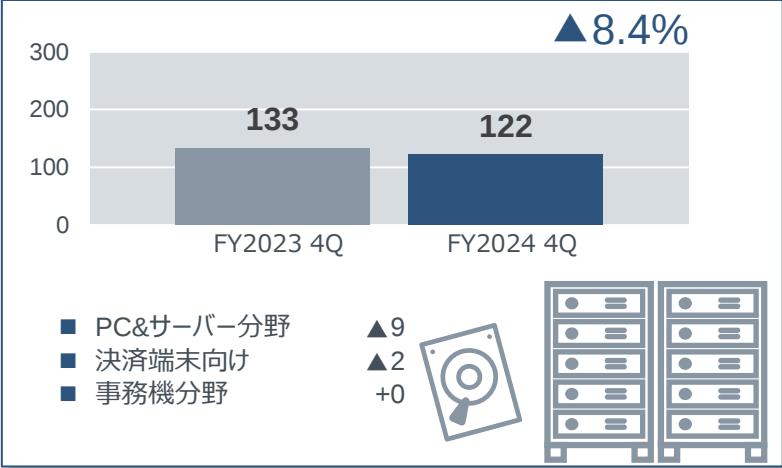
民生



通信



コンピュータ & ストレージ



2024年度 第4四半期 国籍別 売上の変動要因 (前年同期比)

四半期売上高

1,126億円

1,038億円

FY2023 第4四半期実績

FY2024 第4四半期実績

▲7.8%

第4四半期 前年同期比

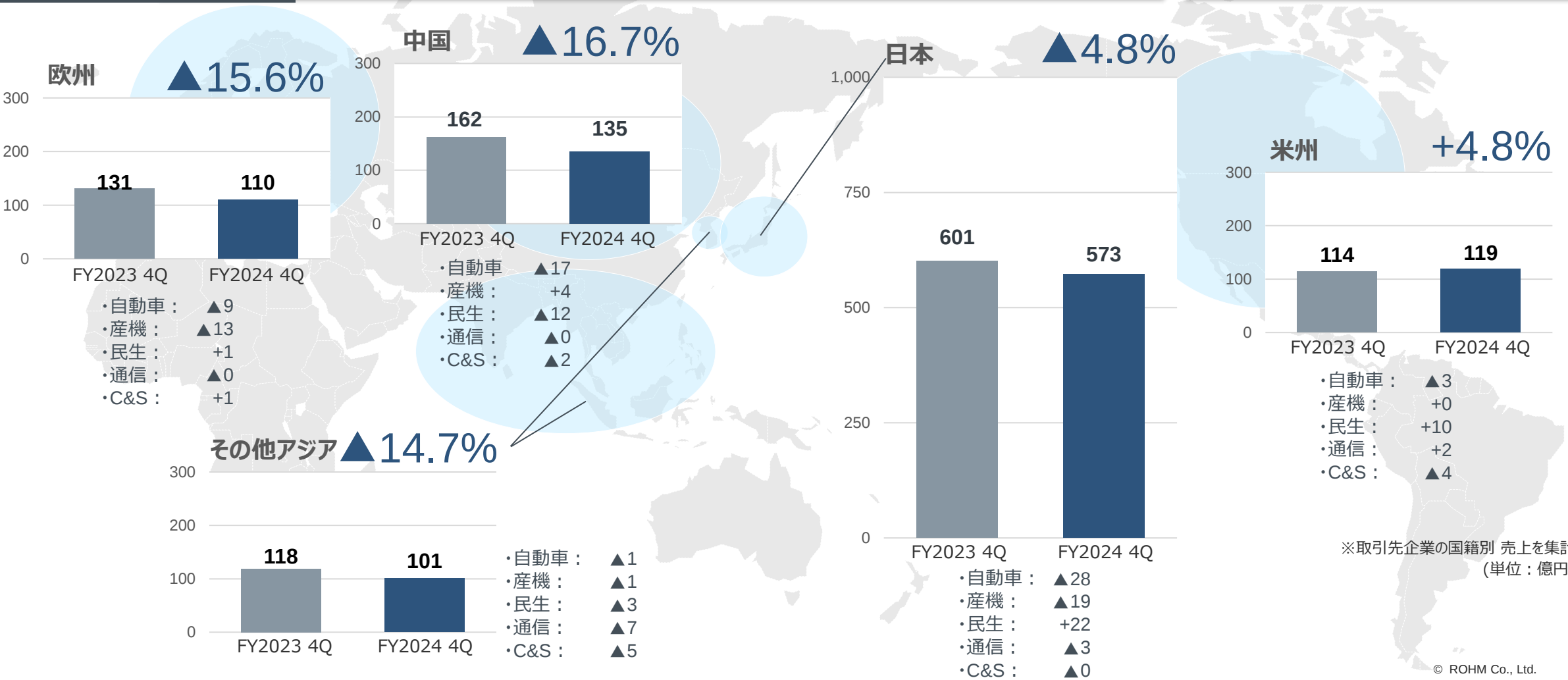
海外売上高比率

46.6%

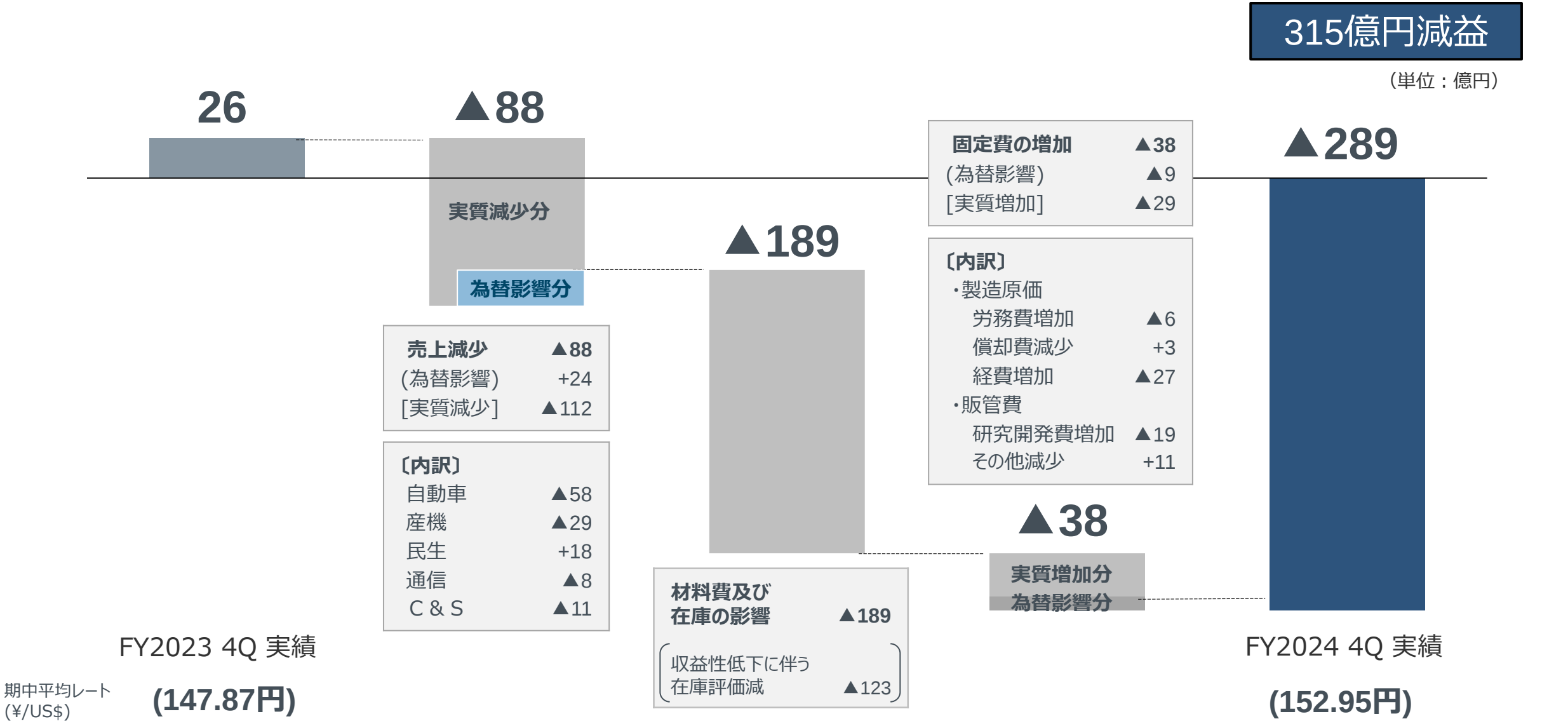
FY2023 第4四半期

44.8%

FY2024 第4四半期



2024年度 第4四半期 営業利益 増減分析 (前年同期比)



2024年度 第4四半期 セグメント別 (前年同期比)



(単位：億円)

		FY2024 第4四半期 実績	FY2023 第4四半期 実績	増減額	増減率
LSI	売上	479	486	▲7	▲1.5%
	セグメント利益	▲47	34	▲81	-
	(利益率)	(▲9.9%)	(7.0%)	-	-
半導体素子	売上	429	503	▲74	▲14.7%
	セグメント利益	▲254	▲15	▲238	-
	(利益率)	(▲59.2%)	(▲3.1%)	-	-
モジュール	売上	68	73	▲4	▲6.0%
	セグメント利益	▲0	▲0	+0	-
	(利益率)	(▲0.3%)	(▲1.2%)	-	-
その他	売上	60	63	▲3	▲4.1%
	セグメント利益	6	4	+2	+33.5%
	(利益率)	(10.4%)	(7.5%)	-	-

2024年度 第4四半期 実績 業績報告 (直前四半期比)



(単位：億円)

	FY2024 第4四半期 実績	FY2024 第3四半期 実績	増減額	増減率
売上高	1,038	1,126	▲88	▲7.8%
営業利益	▲289	▲101	▲188	-
(対売上比率)	(▲27.9%)	(▲9.0%)	-	-
経常利益	▲300	4	▲304	-
(対売上比率)	(▲28.9%)	(0.4%)	-	-
純利益	▲502	▲18	▲484	-
(対売上比率)	(▲48.4%)	(▲1.6%)	-	-
EBITDA	▲70	110	▲180	-
(対売上比率)	(▲6.8%)	(9.9%)	-	-

期中平均レート(¥/US\$) (152.95円) (151.32円)

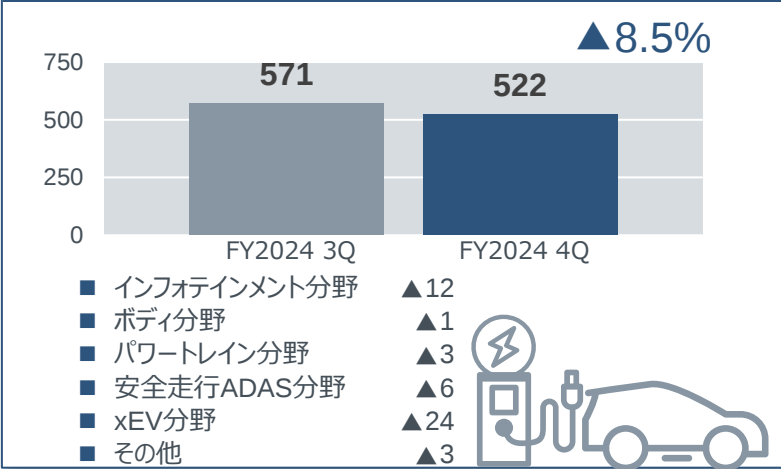
期末レート(¥/US\$) (149.52円) (158.18円)

(単位：億円)

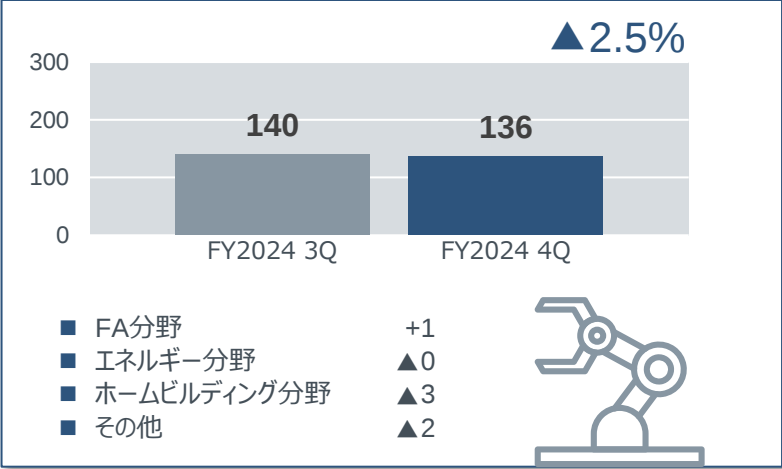
四半期売上高



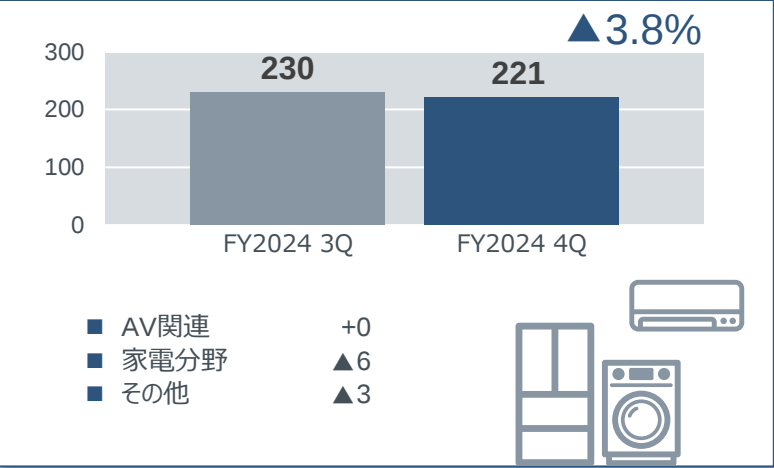
自動車



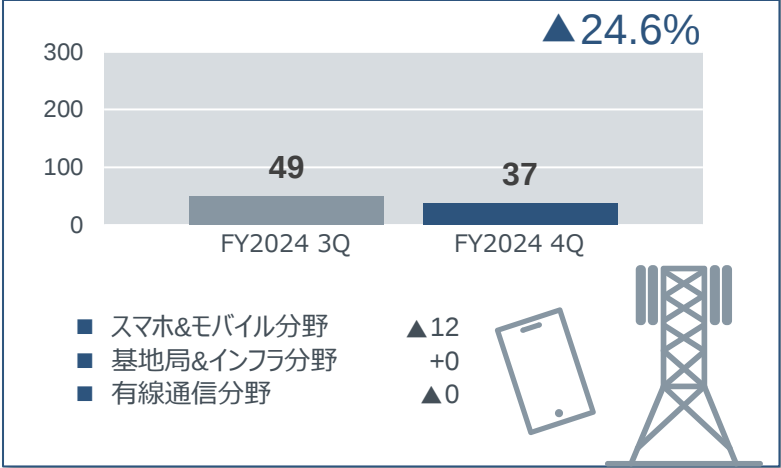
産機



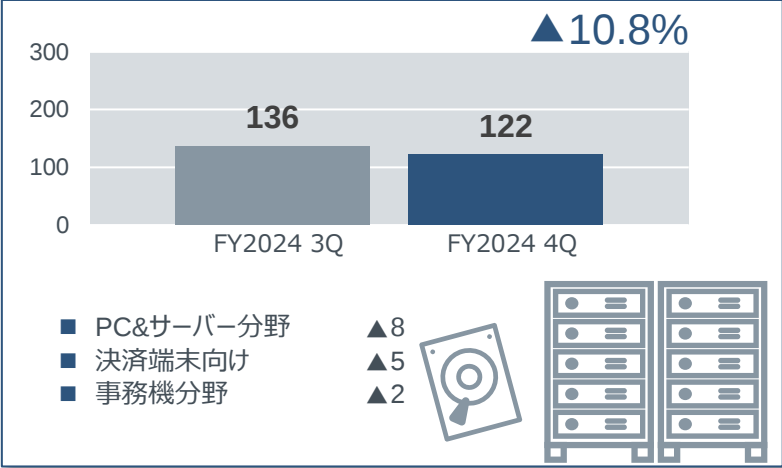
民生



通信



コンピュータ & ストレージ



2024年度 第4四半期 国籍別 売上の変動要因 (直前四半期比)

四半期売上高

1,126億円

1,038億円

FY2024 第3四半期実績

FY2024 第4四半期実績

▲7.8%

第4四半期 直前四半期比

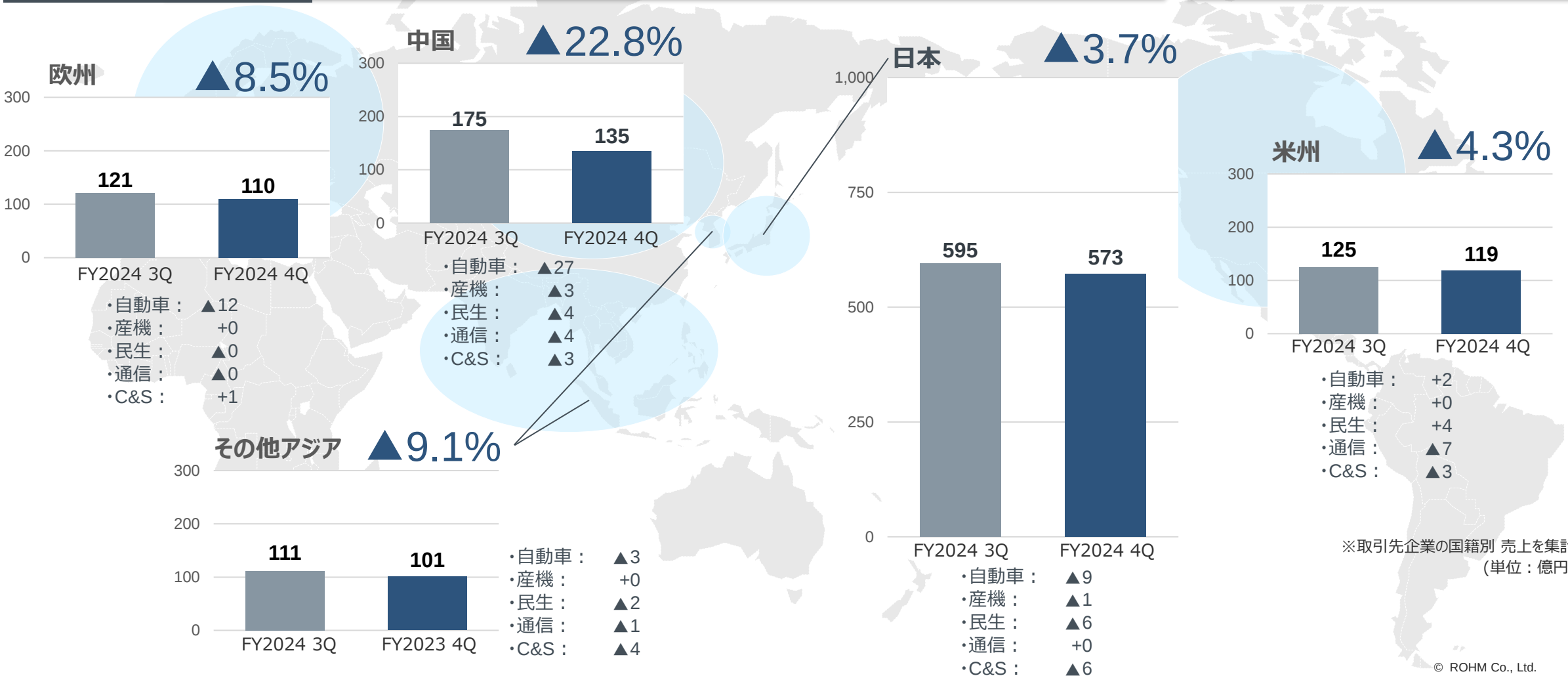
海外売上高比率

47.2%

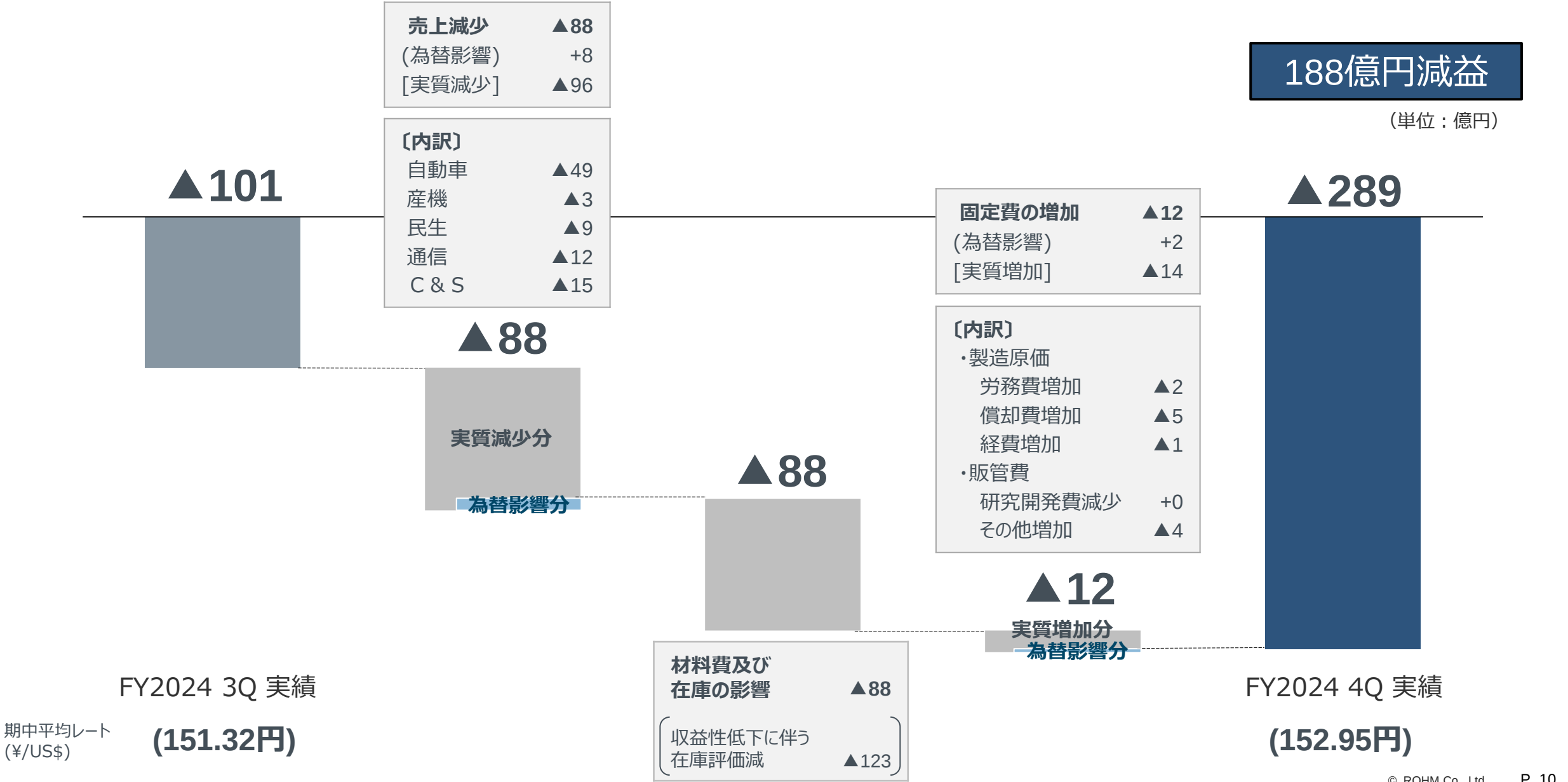
FY2024 第3四半期

44.8%

FY2024 第4四半期



2024年度 第4四半期 営業利益 増減分析（直前四半期比）



2024年度 第4四半期 セグメント別 (直前四半期比)



(単位：億円)

		FY2024 第4四半期 実績	FY2024 第3四半期 実績	増減額	増減率
LSI	売上	479	516	▲37	▲7.2%
	セグメント利益	▲47	▲15	▲32	-
	(利益率)	(▲9.9%)	(▲3.0%)	-	-
半導体素子	売上	429	468	▲39	▲8.4%
	セグメント利益	▲254	▲100	▲154	-
	(利益率)	(▲59.2%)	(▲21.5%)	-	-
モジュール	売上	68	79	▲11	▲13.1%
	セグメント利益	▲0	5	▲5	-
	(利益率)	(▲0.3%)	(7.1%)	-	-
その他	売上	60	61	▲1	▲1.7%
	セグメント利益	6	3	+3	+74.8%
	(利益率)	(10.4%)	(5.9%)	-	-

- [2025-02-13 ロームのEcoGaN™が、村田製作所グループであるMurata Power Solutions のAIサーバー向け電源に採用](#)
- [2025-02-17 4月1日以降の役員体制について](#)
- [2025-02-26 AIサーバー等の高性能サーバー向け、業界トップクラスの低オン抵抗・高耐量MOSFETを開発](#)
- [2025-03-13 業界トップクラスの放射強度！小型・面実装 近赤外LEDを開発](#)
- [2025-03-18 AI機能搭載マイコンを開発](#)
- [2025-03-25 負電圧・高電圧（40V/80V）対応！ 高精度 電流センスアンプ](#)
- [2025-03-27 マツダとローム、次世代半導体を用いた自動車部品の共同開発を開始](#)
- [2025-04-15 業界トップの低オン抵抗！急速充電に最適な小型MOSFETを開発](#)
- [2025-04-24 OBCのデファクトスタンダードへ！高電力密度の新型SiCモジュールを開発](#)
- [2025-05-08 デンソーとローム、半導体分野における戦略的パートナーシップ構築に向けて基本合意](#)
- [2025-05-12 ロームの最新2kV SiC MOSFETを搭載したセмикロンダンフォスのモジュールが、SMAの太陽光システムに採用](#)



Electronics for the Future